



电子周报：台积电上修全年半 导体展望；小米 Q2 全球份额 首次第二



半导体：台积电重申芯片缺货至 2022 年，再次上修半导体全年增长预期

台积电重申，预计芯片短缺趋势将持续到 2022 年。同时，台积电再次上修半导体产业及公司增长展望，预计今年半导体产业（不含存储器）产值将年成长达 17%，较一季度预估的 12% 增长 5 个百分点，晶圆代工产业也由一季度的 16% 上修到年成长 20%；台积电全年营收以美元计预计将超过晶圆制造产业的年成长率，即超过 20%。

在车用芯片方面，台积电表示其今年 MCU 的产量将较 2020 年提升 60%，客户车用芯片短缺现象有望在今年三季度有所改善。

本周，通用汽车鉴于供应链方面的考虑，将在部分新 SUV 车型中取消智能手机无线充电功能。与此同时，芯片短缺也导致个人电脑出货量增长放缓。晶圆厂为了满足终端客户需求积极扩产，台积电规划积极扩大成熟制程的 28nm 产能，预计未来 2~3 年 28nm 月总产能可扩增 10~15 万片。

近日，ICInsights 发布了 2020 年底全球晶圆产能分布。其中，中国台湾地区、韩国、日本和中国大陆分列前四位，分别占比 21.4%、20.4%、15.8% 及 15.3%。ICInsights 预计中国大陆将是唯一在 2020~2025 年产能占有率提升的地区，增长约 3.7%，并将于 2021 年超越日本。随着国内电子企业采购本土芯片意愿增加，叠加芯片缺货趋势，芯片国产化进程得以加快，本土半导体企业迎来发展良机。Gartner 预计中国半导体公司 2025 年的国内市场市占率将从目前的 15% 提升至 30%。我们认为半导体板块高

景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到 2022 年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也将受惠。

设备材料: 晶圆再生工厂在合肥量产, 看好半导体材料设备国产化合肥至微项目正式量产, 这是中国国内首个立项又最先量产的 12 英寸晶圆再生工厂, 该项目全面达产后, 可形成每年 168 万片晶圆再生及 120 万件零部件清洗的能力, 满产后年产值可超过 6 亿元。此前中国高阶的晶圆再生需求都要送到日本、中国台湾等地处理。随着至微项目的量产, 合肥将成为满足晶圆再生需求的重要基地。

当前, 全球半导体产业面临“缺芯”状态, 为提高产能, 台积电、中芯国际等纷纷宣布新晶圆厂的建设计划。我们看好上游半导体材料与设备, 推荐硅片 (沪硅产业、立昂微、中环股份), 光刻胶 (晶瑞股份、华懋科技), 半导体设备 (中微公司、芯源微、至纯科技、精测电子)。

消费电子: 上半年国内手机市场同比增长 13.7%, 二季度小米首次排名全球份额第二信通院发布数据显示, 2021 年上半年, 国内手机市场整体出货量保持快速增长, 出货量 1.74 亿部, 同比增长 13.7%, 其中 5G 手机 1.28 亿部, 同比增长 100.9%。2021 年 6 月, 国内手机市场继续受需求提前释放 (一季度出货量同比增长 100.1%)、移动芯片短缺、华为缺位等因素影响, 同比延续下滑趋势, 但降幅由 4、5 月份的超过 30% 收窄至 10%, 并实现环比增长 11.7%。我们预计下半年国内手机出货量同比将保持持平或微增, 全年出货在 3.2 亿上下, 全年出货增速约为 8%。

Canalys 发布数据显示，随着新冠病毒疫苗在世界各地推出，对于各国经济和公民而言的“新常态”开始形成，2021Q2 全球智能手机出货量增长了 12%。三星出货同比增长 15%，份额 19%，排名第一，小米出货同比增长 83%，份额 17%，首次排名第二，苹果、OPPO、vivo 分别以 14%、10%、10%的市场份额排名三至五位。小米的海外业务迅速增长，在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长了 300%以上、150%和 50%。虽然目前小米在很大程度上仍然偏向大众市场，与三星和苹果公司相比平均售价分别低约 40%和 75%，但是未来高端化将成为小米的下一步重要目标。

从数据上来看，华为让出的高端市场最大的受益者仍然是苹果。三季度 iPhone 拉货旺季即将到来，我们预计将对于消费电子板块业绩及股价表现带来较大提振。

被动元件：停工致产能受限持续，利好国内被动元件龙头近日，马来西亚因疫情封国状态持续，马来政府暂定封锁至本月 22 日。因疫情影响，在马被动元件大厂产能受限大。7 月 15 日，被动元件大厂凯美发布公告，子公司旺途马来西亚复工，但全厂仅能维持 60%产线生产。此前，凯美在本月 9 日因马来西亚疫情影响停工。全球被动元件聚焦马来西亚重镇，MLCC 电容领头羊村田、钽电容 AVX、固态电容领头羊松下等都在马来西亚设厂，工业区停工或产能受限对电容等被动元件供应链影响持续。近日，风华高科发布半年度业绩预报，预计 2021 年上半年实现归母净利润 4.70

亿元至 5.20 亿元，同比增长 108.91%至 121.01%，对应二季度归母净利润为 2.84 亿元至 3.34 亿元，同比增长 118.46%至 156.92%。报告期内，受益电子元器件市场需求旺盛，公司主营产品产销实现同比大幅增长，带动公司经营业绩增长持续。

近日，日本 MLCC 龙头村田制作所表示，MLCC 方面今后三年整体市场成长率达 10%以上，市场需求长期看持续增长；2021 下半年多数 MLCC 客户存货水位较高，预测下半年 MLCC 需求小幅下滑。我们认为，国际疫情持续造成国际市场被动元件产能受限，虽然 MLCC 客户存货水位较高，但厂商被动元器件的备货趋势仍在延续；国内电容龙头风华高科半年度业绩出现大幅增长，兑现国内龙头成长优势。看好国内 MLCC 龙头三环集团、风华高科，电感龙头顺络电子产能扩大、市场占有份额加大而增厚业绩。

建议关注：半导体（士兰微、兆易创新、圣邦股份、思瑞浦、澜起科技、晶晨股份、韦尔股份、卓胜微），消费电子（歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、长盈精密），被动元件（顺络电子、三环集团、风华高科），设备（中微公司、芯源微、至纯科技），材料（沪硅产业、立昂微、

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32966

